

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（北交所）上市（以下简称“本次发行上市”）。公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。本次发行上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,500,000,000 股（含本数，含全额形式）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 225,000,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东会授权董事会于北京证券交易所和

中国证券监督管理委员会批准/注册后，与主承销商自主协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合资格的战略投资者、询价对象以及在北京证券交易所开户并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（7）承销方式及承销期：

余额包销，承销期为招股说明书在中国证券监督管理委员会、北京证券交易所指定报刊刊登之日起至主承销商停止接受投资者认购款之日。

（8）募集资金用途：

根据《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称		拟投资总额（万元）	利用募集资金投资金额（万元）
1	12 英寸 半导体 硅片扩 产项目	年产 360 万片 12 英寸抛光片生产线建设项目（二期）	290,000.00	174,000.00
		年产 240 万片 12 英寸抛光片生产线建设项目	350,000.00	176,000.00
		小计	640,000.00	350,000.00
2	补充流动资金		100,000.00	100,000.00
合计			740,000.00	450,000.00

公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

（9）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行上市成功后，如公司本次公开发行股票前存在滚存未分配利润的，由本次发行后登记在册的公司新老股东按本次发行完成后持有的公司股份比例共享。

（10）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（11）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内公司本次发行上市尚未取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

（12）其他事项说明：

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》，公司 2024 年度、2023 年度研发投入分别为 17,254.51 万元、13,634.19 万元，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

三、 备查文件

1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事审计委员会第九次会议决议》

3、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日